

7/6-7(一、二)半導體達人營 課程

| 時間 | 課程內容 | 課程要點 |
|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 第一天 Day1 | | |
| 第一節 8:30-9:15 | 開場及課程簡介 | |
| 第二節 9:25-10:10 | 積體電路材料篇 | 新一代半導體材料 |
| 第三節 10:20-11:05 | 積體電路元件篇 | 新一代半導體元件 |
| 第四節 11:15-12:00 | 半導體產業鏈 | 介紹半導體發展及產品應用 |
| 午餐 | | |
| 第五節 13:15-14:00 | 半導體製程 | 3D 製程封裝技術 |
| 第六節 14:10-14:55 | 軟硬體協作創意實作構想 | 學習如何安裝和設定 Rabboni 的相關軟體 (實作構想) |
| 第二天 Day2 | | |
| 第一節 8:30-9:15 | 數位邏輯閘 | Gate vs. Transistor |
| 第二節 9:25-10:10 | 積體電路設計 | EDA |
| 第三節 10:20-11:05 | 走近 VLSI 之處理器 | CPU, NPU, GPU |
| 第四節 11:15-12:00 | 百工百業做 AI | AI 應用介紹 |
| 午餐 | | |
| 第五節 13:15-14:00 | 實作 | Rabboni 程式設計動畫與遊戲 設計基礎 |
| 第六節 14:10-14:55 | 成果發表 | 展示作品 |